

成都旭光电子股份有限公司 关于非公开发行募投项目延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以现场及通讯方式召开第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，同意将公司非公开发行募投项目电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）两个项目延期至2024年12月。现将相关情况公告如下：

一、2022年非公开募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。

（二）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
电子封装陶瓷材料扩产项目	否	13,670.86	13,670.86	13,680.72	100.07	2023年
电子陶瓷材料	否	31,979.55	31,979.55	13,976.91	43.71	2023年

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
产业化项目(一期)						
补充流动资金	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00	不适用
合计	53,450.41	53,450.41	53,450.41	35,457.64	66.34	

二、2022年非公开募投项目延期的具体情况及原因

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟将募投项目电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）两个项目进行延期，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
电子封装陶瓷材料扩产项目	2023年	2024年12月
电子陶瓷材料产业化项目（一期）	2023年	2024年12月

（一）电子封装陶瓷材料扩产项目

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。目前项目主体工程已基本竣工，为了进一步提升产能和产品良率，生产设备的优化调试仍持续推进中。为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，结合当前募投项目实施进度，经过综合分析和审慎评估，公司董事会决定将“电子封装陶瓷材料扩充项目”达到预定可使用状态的预计时间延期至2024年12月。

（二）电子陶瓷材料产业化项目（一期）

募投项目建设工作已取得阶段性进展，其中氮化铝基板及结构件产品已达成部分关键指标，但由于国内半导体市场的逐步升级，对相关产品的质量和性能也提出更高的要求，同时，HTCC及氮化硅基板涉及的制造工艺复杂，并且生产验证周期较长。因此，为确保产品质量与性能稳定，更好的服务于客户，后续仍需更多时间进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作，经公司充分考虑和审慎研究，将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的预计时间延期至2024年12月。

此外，受外部经济环境和市场需求波动的影响，公司主动调整了设备预投时间规划。

三、部分募投项目重新论证的情况

据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对投入进度未到50%的“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”进行了重新论证，具体情

况如下：

（一）项目建设必要性及可行性

氮化铝陶瓷因其优秀导热性及与硅相匹配的热膨胀系数，在电子行业有着广泛的应用，成为新一代散热基板和电子器件封装的理想材料。同时，氮化铝在半导体设备零部件也有广泛应用，特别是静电吸盘产品，随着设备功率的提升，氮化铝卡盘渗透率将会显著提高。根据《氮化铝粉体与制品产业发展研究报告》数据推算，预计到 2025 年，国内氮化铝陶瓷基板市场规模有望达到百亿元，未来国产替代空间大。

募集资金投资项目“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”是公司电子陶瓷行业横向拓展，深入构建产业生态链的重要一环。近年来，中国政府颁布一系列相关政策，鼓励陶瓷外壳、陶瓷基座等电子陶瓷配套器件国产化。《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》《基础电子元器件产业发展行动计划》《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》《重点新材料首批应用示范指导目录》等政策不断推动中国电子陶瓷行业转型升级，电子陶瓷行业发展空间巨大。目前，公司积极响应政府政策，已打通从前端陶瓷粉体制备烧结到后端电子陶瓷基板、结构件、HTCC 等产品生产全产业链，产品整体技术实力得到不断升级和发展。

综上，公司募投项目仍然具备投资的必要性和可行性。

（二）项目预计收益

综合来看，项目建成后将取得良好的经济效益，公司将进一步提升盈利能力及核心竞争力，有利于公司开拓新业务，增强公司中长期发展后劲，提高公司的技术实力和品牌影响力，为未来的可持续发展奠定坚实基础，符合公司未来发展方向。

（三）重新论证的结论

经重新论证，公司认为上述募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

四、募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对公司经营业务产生不利影响，是公司根据实际建设情况和投资进度进行的合理调整，符合公司的长远发展规划。本次延期后，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件

的规定，积极协调相关资源配置，有序稳步推动项目实施，使项目按新的计划进度进行，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督。

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年非公开发行募投项目延期的议案》，同意将公司非公开发行募投项目电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）两个项目预定可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 26 日，公司第十届监事会第二十次会议审议并通过了《关于 2022 年非公开发行募投项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期，是公司根据实际建设情况和投资进度进行的合理调整，符合公司的发展战略，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2022 年非公开发行募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：旭光电子募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，是基于市场和公司实际经营情况做出的调整，符合公司实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司募投项目延期事项无异议。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日